



PCIM Europe 2018, Nuremberg - Hall 9 - Stand 301

Toshiba développe un IEGT "press-pack" 4,5 kV offrant une résistance améliorée à la rupture

Ce nouveau concept de boîtier offre une résistance à la rupture 70% supérieure à celle des boîtiers "press-pack" conventionnels

Düsseldorf, Allemagne, 29 mai 2018 - Toshiba Electronics Europe va fournir des détails sur son nouveau boîtier pour dispositifs PPI (Press-Pack Injection Enhanced Gate Transistor, ou transistor à grille amélioré par injection en boîtier "press-pack") classe 4,5 kV, lors de la conférence PCIM 2018 à Nuremberg. Ce nouveau boîtier a été développé pour améliorer encore la résistance à la rupture du dispositif, afin de réduire le risque d'endommager les composants et systèmes environnants en cas de défaillance.

Ce boîtier est le résultat de recherches entreprises pour évaluer le rapport volumique optimal des différents matériaux dans un boîtier de ce type. Expérimentalement, on a pu déterminer le rapport optimal pour qu'il n'y ait ni destruction de la céramique, ni fuite de matériau.

Des mesures précises ont démontré que ce boîtier était capable de résister à 50 heures en mode défaillance court-circuit (Short-Circuit Failure Mode ou SCFM). L'expérimentation a été

réalisée avec une puce IEGT court-circuitée parmi 42 puces similaires, à l'endroit le plus défavorable.

De plus, les tests de résistance à la rupture, réalisés à l'aide d'une tension de test de 3200V, ont montré une résistance 70% plus élevée qu'avec les dispositifs PPI standard.

Ces résultats de recherche seront présentés à la conférence PCIM Europe 2018, par Raita Kotani et Georges Tchouangue, jeudi 7 juin à 11h15.

###

A propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe](#) (TEE) est la division européenne de composants électroniques de [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE offre aux consommateurs et aux entreprises européennes un large choix de disques durs (HDD) et de semiconducteurs innovants pour les applications automobiles, industrielles, IoT (Internet of Things, ou Internet des objets), de contrôle d'axe, de télécommunications, de réseaux, de grand-public ou d'électro-ménager. Le large catalogue de la société comprend des CI sans-fil, des semiconducteurs de puissance, des microcontrôleurs, des semiconducteurs optiques, des ASIC (circuits intégrés spécifiques), des ASSP et des dispositifs discrets allant de diodes à des CI logiques.

Fondé en 1973 à Neuss en Allemagne, TEE a son siège à Düsseldorf en Allemagne, et possède des filiales en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, assurant la conception, la fabrication, le marketing et les ventes. Le président de la société est M. Akira Morinaga.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Toshiba Electronics Europe : www.toshiba.semicon-storage.com.

Personne à contacter pour les questions concernant la publication:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Pour des informations concernant la publication, contactez:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Publié par:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Mai 2018

Réf : 7132/A